股票代码:600460 股票简称:士兰微 上市地点:上海证券交易所

杭州士兰微电子股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要

发行对象/认购人	
发行股份购买资产交易对方	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
募集配套资金认购方	不超过35名符合条件的特定投资者

独立财务顾问

东方证券 ORIENT SECURITIES 投资银行

东方证券承销保荐有限公司
ORIENT SECURITIES INVESTMENT BANKING CO., LTD

签署日期:二〇二〇年十二月

上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明

一、本公司/本人将及时向参与本次交易的中介机构提供与本次交易相关的信息、资料、文件或出具相关的确认、说明或承诺;本公司/本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、本公司/本人保证向参与本次交易的各中介机构提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、本公司/本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

四、本公司/本人保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本公司/本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司/本人审阅,确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五、本公司/本人对所提供的信息、资料、文件以及所出具相关的确认、说明或承诺的真实性、准确性和完整性承担法律责任;如因本公司/本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,经司法/证券监管机关认定给上市公司或者投资者造成损失的,本公司/本人将依法承担个别和连带的法律责任。

六、作为公司董事、监事、高级管理人员,本人承诺:如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本人将暂停转让在公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会,由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定;若未能在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的主体资格信息和账户信息并申请锁定;若董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的主体资格信息和账户信息并申请锁定;若董事会未向证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

交易对方声明

本次发行股份购买资产的交易对方承诺:

一、本公司保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、本公司保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、本公司保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

四、本公司保证本次重组的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本公司所出具的文件及引用文件的相关内容已经本公司审阅,确认本次重组申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五、本公司保证在参与本次重组期间将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定,及时向上市公司披露有关本次交易的信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,本公司将依法承担相应的法律责任。

七、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本公司将暂停转让在该上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定;若未能在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的主体资格信息和账户信息并申请锁定;若董事会未向证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

中介机构声明

本次交易的独立财务顾问东方证券承销保荐有限公司已出具声明:“本公司及经办人员同意杭州士兰微电子股份有限公司在《杭州士兰微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要中引用本公司出具的结论性意见,且所引用的结论性意见已经本公司及经办人员审阅,确认《杭州士兰微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别或连带的法律责任。本公司承诺:如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任。”

本次交易的法律顾问国浩律师(杭州)事务所已出具声明:“本所及本所经办律师同意《杭州士兰微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要引用本所出具的法律意见书的内容,且所引用内容已经本所及本所经办律师审阅,确认《杭州士兰微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要中不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别或连带的法律责任。本公司承诺:如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本所出具的法律意见书的内容的真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。本所承诺:如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失,经司法机关生效判决认定系本所未能勤勉尽责所致的,本所将承担连带赔偿责任。”

本次交易的审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)已出具声明:“本所及签字注册会计师已阅读《杭州士兰微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(以下简称报告书)及其摘要,确认报告书及其摘要与本所出具的《审计报告》(天健审〔2020〕10354号、天健审〔2020〕10355号)和《审阅报告》(天健审〔2020〕10347号)的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对杭州士兰微电子股份有限公司在报告书及其摘要中引用的上述报告内容无异议,确认重组报告书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。”

本次交易的资产评估机构坤元资产评估有限公司已出具声明:“本公司及签字资产评估师已阅读《杭州士兰微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(以下简称报告书)及其摘要,确认报告书及其摘要中引用的相关内容与本公司出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2020〕742号)、《资产评估报告》(坤元评报〔2020〕743号)的内容无矛盾之处。本公司及签字资产评估师对杭州士兰微电子股份有限公司在报告书及其摘要中引用的上述报告内容无异议,确认报告书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本公司未能勤勉尽责的,本公司将承担连带赔偿责任。”

释义

在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

一、一般释义

本报告书	指	《杭州士兰微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》
重组报告书	指	《杭州士兰微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
本次交易、本次重组	指	杭州士兰微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的行为
士兰微、上市公司、公司、本公司	指	杭州士兰微电子股份有限公司
标的公司	指	杭州集华投资有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司
交易对方、大基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
华芯投资	指	华芯投资管理有限责任公司,系国家集成电路产业投资基金股份有限公司的基金管理人
交易双方	指	士兰微、大基金
集华投资	指	杭州集华投资有限公司
士兰集昕	指	杭州士兰集昕微电子有限公司
标的资产、拟购买资产、交易标的、标的股权	指	集华投资19.51%的股权以及士兰集昕20.38%的股权
发行股份购买资产的定价基准日	指	第七届董事会第十二次会议决议公告日,即2020年7月25日
审计/评估基准日	指	2020年7月31日
报告期、最近两年及一期	指	2018年度、2019年度、2020年1-7月
士兰控股	指	杭州士兰控股有限公司,士兰微的控股股东
士兰集成	指	杭州士兰集成电路有限公司
高新科创	指	杭州高新科技创业服务有限公司
英飞凌	指	英飞凌科技公司(Infineon Technology AG)
《2016年投资协议》	指	《国家集成电路产业投资基金股份有限公司与杭州士兰微电子股份有限公司与杭州士兰集成电路有限公司与杭州集华投资有限公司与杭州士兰集昕微电子有限公司关于杭州集华投资有限公司及杭州士兰集昕微电子有限公司之投资协议》
《2019年投资协议》	指	《国家集成电路产业投资基金股份有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、杭州集华投资有限公司、杭州士兰集成电路有限公司与杭州士兰集昕微电子有限公司关于杭州士兰集昕微电子有限公司之投资协议》
8吋线、8英寸生产线	指	8英寸集成电路芯片生产线
交割日	指	标的公司就本次重组完成工商变更登记手续,将标的资产登记在士兰微名下之日
《发行股份购买资产协议》	指	《杭州士兰微电子股份有限公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产协议之补充协议》	指	《杭州士兰微电子股份有限公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
独立财务顾问、东方投行	指	东方证券承销保荐有限公司
律师、国浩律师	指	国浩律师(杭州)事务所
审计机构、天健会计师	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
评估机构、坤元评估	指	坤元资产评估有限公司
中和资产	指	中和资产评估有限公司
《审计报告》	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)的天健审〔2020〕10354号《审计报告》和天健审〔2020〕10355号《审计报告》
《审阅报告》、审阅报告	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2020〕10347号《审阅报告》
743号《评估报告》	指	《杭州士兰微电子股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的杭州集华投资有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2020〕743号)
742号《评估报告》	指	《杭州士兰微电子股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的杭州士兰集昕微电子有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2020〕742号)
《评估报告》、评估报告	指	《杭州士兰微电子股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的杭州集华投资有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2020〕743号)、《杭州士兰微电子股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的杭州士兰集昕微电子有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2020〕742号)
并购重组委	指	中国证监会上市公司并购重组审核委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《士兰微募集资金管理办法》	指	《杭州士兰微电子股份有限公司募集资金管理办法》
《公司章程》	指	《杭州士兰微电子股份有限公司章程》
吋	指	英寸
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

二、专业释义

IDM	指	Integrated Design & Manufacture,设计与制造一体模式
集成电路、芯片	指	集成电路(Integrated Circuit,简称IC,俗称芯片)是一种微型电子器件或部件,采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构
功率器件、半导体功率器件	指	具有处理高电压、大电流、输出较大功率作用的半导体分立器件,在多数情况下,被用作开关与整流使用
分立器件	指	只具备单一功能的电路,包括电容、电阻、晶体管和绝断丝等
硅片	指	单晶硅圆片,由普通硅沙拉制提炼而成,是最常用的半导体材料,又称为硅抛光片
晶圆	指	在圆形晶硅片表面加工制作各种电路元件结构并具有特定电性功能的集成电路产品
外延片	指	经过外延工艺在衬底上形成外延层的硅片
MEMS	指	微机电控制系统(Micro-Electro-Mechanical Systems)是集微型结构、微型传感器、微型执行器以及信号处理和控制电路、直至接口、通信和电源等于一体的微型器件或系统
IGBT	指	绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件,兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点
IPM	指	智能功率模块,不仅把功率开关器件和驱动电路集成在一起,而且还内置有过电压、过电流和过热等故障检测电路,并可将检测信号送到CPU。它由高速低功耗的管芯和优化的门极驱动电路以及快速保护电路构成
肖特基管	指	肖特基(Schottky)二极管,在通信电源、变频器等中比较常见。是以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管芯片,具有反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降更低(仅0.4V左右)的特点
LED	指	Lighting Emitting Diode,即发光二极管,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫等单色的光
CSIA	指	中国半导体行业协会(China Semiconductor Industry Association)

本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

重大事项提示

一、本次交易方案概述

本次交易方案包括发行股份购买资产和非公开发行股票募集配套资金两部分。

(一)发行股份购买资产

1、发行对象及购买资产

本次交易前,上市公司直接持有集华投资51.22%的股权,直接持有士兰集昕6.29%的股权。集华投资为士兰集昕的第一大股东,其直接持有士兰集昕47.25%的股权。

上市公司拟通过发行股份方式购买大基金持有的集华投资19.51%的股权以及士兰集昕20.38%的股权。除本次交易外,上市公司没有对收购集华投资、士兰集昕剩余股权与包括大基金在内的其他股东签署过相关安排或协议。

本次交易完成后,上市公司将直接持有集华投资70.73%的股权,直接持有士兰集昕26.67%的股权。集华投资对士兰集昕的持股比例保持不变。上市公司将通过直接和间接方式合计持有士兰集昕63.73%的股权权益。

本次交易完成后,上市公司的控股股东仍为士兰控股,实际控制人仍为陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华等七人,本次交易不会导致上市公司控制权和实际控制人发生变更。

2、标的资产估值及作价情况

根据坤元评估出具的坤元评报〔2020〕743号《评估报告》,评估机构采用了资产基础法对集华投资进行评估,截至评估基准日2020年7月31日,集华投资的整体估值为1,747,913,783.40元(大写为人民币壹拾柒亿肆仟柒佰玖拾壹万叁仟柒佰捌拾叁圆肆角),对应其19.51%的股权价值为341,017,979.14元。

根据坤元评估出具的坤元评报〔2020〕742号《评估报告》,评估机构采用了市场法和资产基础法对士兰集昕进行评估,并最终采用市场法评估结果作为标的公司股东全部权益的评估值。截至评估基准日2020年7月31日,士兰集昕的整体估值为3,644,000,000.00元(大写为人民币叁拾陆亿肆仟肆佰万圆整),对应其20.38%的股权价值为742,647,200.00元。标的资产评估值合计为1,083,665,179.14元。

根据上述评估值,各方经友好协商后,集华投资19.51%股权最终交易定价为353,217,015.92元;士兰集昕20.38%股权最终交易定价为769,213,484.08元。本次重组标的资产的整体作价合计为1,122,430,500.00元,较标的资产评估值溢价3.58%。截至本报告书签署日,《评估报告》的相关国有资产监管部门备案程序尚未完成,标的资产的最终交易价格将依据备案完成的评估结果综合确定。

3、股票发行价格

本次交易中,上市公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为公司审议本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的董事会决议公告日,即第七届董事会第十二次会议决议公告日。经交易各方友好协商,本次发行股份购买资产的发行价格定为13.63元/股,不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。

4、支付方式及支付数量

本次交易发行股份购买资产的支付对价及发行股份数量情况如下:

序号	交易对方	标的资产	股份支付对价(万元)	股份支付数量(股)
1	大基金	集华投资19.51%股权	35,321.70	25,914,675
2	大基金	士兰集昕20.38%股权	76,921.35	56,435,325
合计			112,243.05	82,350,000

(二)募集配套资金

上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过112,200.00万元且不超过拟购买资产交易价格的100%,同时,发行股份数不超过本次交易前上市公司总股本的30%。本次交易上市公司向投资者非公开发行股票募集配套资金的发行价格不低于上市公司募集配套资金发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

(三)标的资产估值情况

本次交易中,标的资产的评估基准日为2020年7月31日,根据坤元评估出具的评估报告,标的资产于评估基准日的评估情况如下:

单位:万元

标的资产	100%股权账面价值	100%股权评估值	增减值	增减率	收购比例	标的资产评估值
	A	B	C=B-A	D=C/A	E	F=E*B
集华投资	86,036.01	174,791.38	88,755.37	103.16%	19.51%	34,101.80
士兰集昕	159,901.99	364,400.00	204,498.01	127.89%	20.38%	74,264.72
合计						108,366.52

注:标的公司集华投资持有标的公司士兰集昕47.25%的股权。

本次交易双方在坤元评估出具评估报告的评估值基础之上进行友好协商,约定本次交易作价为112,243.05万元,较标的资产评估值溢价3.58%。

二、本次交易的性质

(一)本次交易不构成重大资产重组

根据上市公司和标的公司2019年审计报告,相关财务数据占比计算的结果如下:

单位:万元

项目	标的	计算	资产总额	资产净额	营业收入
财务指标	集华投资	a	70,226.64	70,220.65	-
	士兰集昕	b	266,358.63	129,712.04	46,670.39
	合计	c=a+b	336,585.27	199,932.69	46,670.39
标的公司少数股权对应财务指标	集华投资	d=a*19.51%	13,701.22	13,700.05	-
	士兰集昕	e=b*20.38%	54,283.89	26,435.31	9,511.42
	合计	f=d+e	67,985.11	40,135.36	9,511.42
士兰微财务指标		g	891,326.02	337,897.84	311,057.38
财务指标占比		h=f/g	7.63%	11.88%	3.06%

同时考虑交易价格因素后,相关计算指标如下:

项目	金额	备注
发行股份价格(元/股)	13.63	
成交股数(股)	82,350,000.00	
本次交易作价(元)	1,122,430,500.00	
累计成交金额预估(元)	1,122,430,500.00	
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,378,978,407.39	上市公司2019年末归母净资产
成交金额预估/归属于上市公司股东的净资产	33.2180%	

根据上述测算,本次交易标的相关财务指标、交易作价指标占比未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准,本次交易不构成重大资产重组。

同时,本次交易采取发行股份购买资产的方式,需通过并购重组委的审核,并取得中国证监会核准后方可实施。

(二)本次交易构成关联交易

公司本次发行股份购买资产的交易对方为大基金,根据交易方案,本次交易完成后,大基金将成为本公司持股5%以上的股东。根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次交易构成关联交易。

公司于2020年7月24日召开第七届董事会第十二次会议审议通过《关于杭州士兰微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等相关议案,关联董事纪路回避表决。

公司于2020年12月30日召开第七届董事会第十六次会议审议通过《关于杭州士兰微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》等相关议案,关联董事纪路回避表决。公司独立董事就本次交易相关关联交易议案进行了事前审查认可,并发表了独立意见。

(三)本次交易不构成重组上市

本次交易前36个月内,上市公司控股股东始终为士兰控股,实际控制人始终为陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权、陈国华等七人。本次交易完成后,上市公司的控股股东和实际控制人均保持不变,本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的情形,本次交易不构成重组上市。

三、发行股份购买资产

(一)发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易发行股份购买资产的发行股份种类为人民币普通股(A股),每股面值为1.00元,上市地点为上海证券交易所。

(二)发行方式及发行对象

本次交易发行股份购买资产的发行方式为向特定对象非公开发行股票,发行股份对象为交易对方国家集成电路产业投资基金股份有限公司。

(三)标的资产的定价原则及交易价格

1、标的资产的定价原则

本次重组中,标的资产的交易价格以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的并经有权国有资产监管部门备案的评估报告的评估结果为参考依据。标的资产的评估情况如下:

(1)集华投资

根据坤元评估出具的坤元评报〔2020〕743号《评估报告》,以2020年7月31日为评估基准日,集华投资的评估结果如下:

单位:元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率
	A	B	C=B-A	D=C/A*100%
一、流动资产	24,986,456.59	26,266,822.57	1,280,365.98	5.12%
二、非流动资产	835,516,714.34	1,721,790,000.00	886,273,285.66	106.07%
其中:长期股权投资	835,516,714.34	1,721,790,000.00	886,273,285.66	106.07%
资产总计	860,503,170.93	1,748,056,822.57	887,553,651.64	103.14%
三、流动负债	143,039.17	143,039.17	-	0.00%
负债合计	143,039.17	143,039.17	-	0.00%
股东全部权益	860,360,131.76	1,747,913,783.40	887,553,651.64	103.16%

以2020年7月31日为评估基准日,集华投资100%权益汇总的资产账面价值860,503,170.93元,评估价值1,748,056,822.57元,评估增值887,553,651.64元,增值率为103.14%;负债账面价值143,039.17元,评估价值143,039.17元;股东全部权益账面价值860,360,131.76元,评估价值1,747,913,783.40元,评估增值887,553,651.64元,增值率为103.16%。

(2)士兰集昕

根据坤元评估出具的坤元评报〔2020〕742号《评估报告》,以2020年7月31日为评估基准日,士兰集昕的评估结果如下:

单位:元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率
	A	B	C=B-A	D=C/A*100%
股东全部权益	1,599,019,947.61	3,644,000,000.00	2,044,980,052.39	127.89%

由于资产基础法固有的特性,采用该方法是通过对被评估单位的资产及负债进行评估来确定企业的股东全部权益价值,未能对工艺路线、企业管理水平、人才技术团队、自创商誉等重要的无形资产单独进行评估,无法体现在目前国际形势中半导体、芯片制造企业的市场价值,由此导致资产基础法与市场法两种方法下的评估结果产生差异。以市场法得出的评估值更能科学合理地反映企业股东全部权益的价值。

在市场法测算前提下,被评估单位股东全部权益计算公式如下:

被评估单位股东全部权益价值=可比公司价值比率×价值比率修正系数×被评估单位财务指标×(1-缺少流动性折扣率)+非经营性资产价值

因此,本次评估最终采用市场法评估测算结果3,644,000,000.00元作为士兰集昕公司股东全部权益的评估价值。

2、标的资产的交易价格

根据上述评估值,各方经友好协商后,集华投资19.51%股权最终交易定价为35,321.70万元,士兰集昕20.38%股权最终交易定价为76,921.35万元,本次重组标的资产的整体作价合计为112,243.05万元,较标的资产评估值溢价3.58%。截至本报告书签署日,《评估报告》的相关国有资产监管部门备案程序尚未完成,标的资产的最终交易价格将依据备案完成的评估结果综合确定。

(四)对价支付方式

上市公司拟全部通过发行股份方式向交易对方支付交易对价。本次交易发行股份购买资产,公司向交易对方支付的股份对价的具体情况如下:

序号	标的公司	名称	对标的公司的出资额(万元)	本次转让的出资额(万元)	交易对价(万元)	股份对价(万元)	发行股份(股)
1	集华投资	大基金	50,000.00	20,000.00	35,321.70	35,321.70	25,914,675
2	士兰集昕	大基金	57,574.60	40,000.00	76,921.35	76,921.35	56,435,325
合计					112,243.05	112,243.05	82,350,000

(五)定价基准日和发行股份的价格

1、定价基准日

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第七届董事会第十二次会议决议公告日,即2020年7月25日。

2、发行价格的确定

根据《重组管理办法》相关规定:上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日即公司第七届董事会第十二次会议决议公告日(2020年7月25日)前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日及120个交易日的上市公司股票交易均价情况如下:

交易均价类型	交易均价(元/股)	交易均价的90%(元/股)
定价基准日前20个交易日	15.60	14.04
定价基准日前60个交易日	15.14	13.62
定价基准日前120个交易日	16.65	14.98

交易均价的计算公式为:定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

根据上市公司与交易对方之间的协商,为兼顾各方利益,本次发行股份购买资产的发行价格定为13.63元/股,不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%,符合《重组管理办法》的相关规定。最终发行价格尚待士兰微股东大会审议批准。

(六)发行股份的数量

本次交易中,集华投资19.51%股权的交易作价为35,321.70万元,公司将全部以发行股份的方式支付,按照每股13.63元的发行价格计算,发行股份数量为25,914,675股;士兰集昕20.38%股权的交易作价为76,921.35万元,公司将全部以发行股份的方式支付,按照每股13.63元的发行价格计算,发行股份数量为56,435,325股。因此,本次交易,公司将合计发行股份数量为82,350,000股,占公司发行后总股本(不考虑配套募集资金)的5.91%。

本次交易发行股份购买资产中交易对方获得的上市公司新增股份数量以股份对价除以发行价格计算,发行数量精确至股。

(七)调价机制

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价格将根据中国证监会、上交所的相关规则进行相应调整除上述除息、除权事项导致的发行价格调整外,本次交易不设置发行价格调整机制。

(八)股份锁定期

交易对方大基金在本次交易中取得的上市公司对其发行股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让。若大基金在本次交易中取得的上市公司股份的锁定期承诺与法律法规、监管机构的最新监管意见不相符,大基金将根据法律法规、监管机构的最新监管意见进行相应调整。

(九)交割后标的公司权益归属

本次交易完成后,交易双方按本次交易完成后的股权比例享有标的公司的权益。

(十)业绩补偿承诺

本次交易不设置业绩补偿承诺。

四、募集配套资金

(一)发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易发行股份募集配套资金的股份种类为境内上市人民币A股普通股,每股面值为人民币1.00元,上市地点为上海证券交易所。

(二)发行对象、发行方式和认购方式

本次交易发行股份募集配套资金的发行方式为向特定对象非公开发行;发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格的境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。该等特定投资者均以现金认购本次发行的股份。

(三)定价基准日和发行股份的价格

本次募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金发行期首日,发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后,由上市公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与本次交易的独立财务顾问(主承销商)协商确定。

在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则上述发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。

(四)发行股份的数量

上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过112,200.00万元且不超过拟购买资产交易价格的100%,同时,发行股份数不超过本次交易前上市公司总股本的30%。

最终发行的股份数量,将在募集配套资金获得中国证监会核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,结合市场情况及根据发行对象申购报价的情况,与本次交易的独立财务顾问(主承销商)协商确定。

在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则上述发行数量将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。

(五)股份锁定安排

上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金发行的股份,自发行结束之日起6个月内不以任何方式转让。本次募集配套资金完成后,认购方因公司发生配股、送股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份,亦应遵守上述股份锁定约定。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

(六)募集配套资金用途

本次交易中,发行股份募集配套资金总额不超过112,200.00万元,在扣除中介机构费用后,将用于8英寸集成电路芯片生产线二期项目和偿还上市公司银行贷款,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投资金额
1	8英寸集成电路芯片生产线二期项目	150,840.00	56,100.00
2	偿还银行贷款	-	56,100.00
合计			112,200.00

本次募集配套资金用于偿还上市公司银行贷款的比例未超过募集配套资金总额的50%。

募集资金到位后,中介机构费用拟从“8英寸集成电路芯片生产线二期项目”中优先扣除,最终实际用于“8英寸集成电路芯片生产线二期项目”的募集资金不超过56,100.00万元。若配套募集资金金额不足以满足上述用途需要,上市公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。在配套募集资金到位前,上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹的资金择机先行用于上述募集配套资金用途,待募集资金到位后予以置换。

五、本次交易标的估值和作价情况

根据坤元评估出具的坤元评报〔2020〕743号《评估报告》,评估机构采用了资产基础法对集华投资进行评估,截至评估基准日2020年7月31日,集华投资的整体估值为1,747,913,783.40元(大写为人民币壹拾柒亿肆仟柒佰玖拾壹万叁仟柒佰捌拾叁圆肆角),对应其19.51%的股权价值为341,017,979.14元。

(下转B170版)

证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临2020-067

杭州士兰微电子股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“士兰微”)第七届董事会第十六次会议于2020年12月30日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2020年12月25日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员,并电话确认。会议应到董事12人,实到12人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

一、会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

杭州士兰微电子股份有限公司拟通过发行股份方式购买国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的杭州集华投资有限公司19.51%的股权以及杭州士兰集昕微电子有限公司20.38%的股权,同时公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次重组”或“本次交易”)。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定,对照上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的条件,公司经过对实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合前述法律、法规和中国证监会有关规范性文件的规定,符